

高機能薄膜用ターゲット (MVF合金・NVF合金)

Target materials for high-performance thin film
(MVF alloy, NVF alloy)

当社開発のMVF合金・NVF合金ターゲットを
薄膜デバイスで積層することで、
高耐環境性や半田接合性を実現。

High environmental resistance and Solderability can be realized by laminating our MVF alloy and NVF alloy targets on thin film devices.



電動化社会に向けた技術コーナー

概要

MVF合金・NVF合金は高耐湿性・耐酸化性・半田接合性など高機能を有するため、各種材料を保護し、軽量・省スペース、信頼性向上に寄与する。

Since MVF alloy and NVF alloy have high functions such as high moisture resistance, oxidation resistance, and Solderability, they can protect such as Cu thin film and realize lightweight, space-saving, and highly reliable film wiring.

用途

フィルム配線
半導体実装基板など

Film wiring, semiconductor mounting substrates, etc.

特長

MVF合金

MVF Alloy

- 各種材料の耐湿性・耐酸化性を向上。
- 500℃加熱後変色なし(SUS箔表面酸化抑制)。

SUS304箔

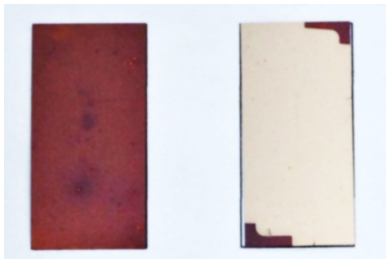


図:大気加熱後の外観

MVF合金 : 0.2μm

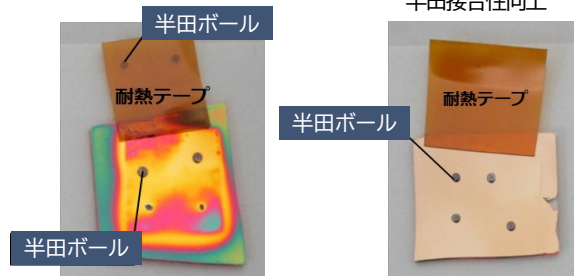
SUS304箔

NVF合金

NVF Alloy

- 耐湿性・耐酸化性に劣る低抵抗なCu膜を保護。
- 半田との高い接合性を実現。

Cu膜表面の酸化抑制
半田接合性向上



Cu単層

Cu/NVF合金

図:半田ボール接合テスト後の外観



Filmヒーター(ステアリングヒーター見本)
厚み50μmのPI film上に
Cu\NVF合金を形成し切り抜き。

LEDランプ点灯



厚さ : 0.05mm

蓋の隙間をスルー

Film配線
厚み50μmのPI film上に
Cu\NVF合金を形成し切断

被覆配線→Film配線
半田接合

